

证券代码：874810

证券简称：中欣晶圆

主办券商：财通证券

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所

上市摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”或“本次发行并上市”）。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件的规定，为保障中小投资者利益，公司就公司本次发行上市对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就防范本次发行并上市摊薄即期回报提出相关措施及承诺，具体如下：

（一）巩固并拓展公司主营业务，提升公司持续盈利能力

本次发行并上市完成后，公司资产负债率及财务风险将有所降低，公司资本实力和抗风险能力将进一步加强，从而保障公司稳定运营和长远发展，符合股东利益。随着本次发行并上市完成后，公司资金实力进一步提升，公司将大力推进技术研发，巩固并拓展公司主营业务，提升公司产品的市场占有率，提升公司持续盈利能力，为股东带来持续回报。

（二）加强募集资金管理，合理使用募集资金

本次发行股票募集资金符合行业相关政策，有利于公司经济效益持续增长和

公司可持续发展。随着本次募集资金的到位，将有助于公司实现规划发展目标，进一步增强公司资本实力，满足公司经营的资金需求。

为保障公司规范、有效使用募集资金，在本次募集资金到位后，公司将积极调配资源，加快推进募集资金投资项目建设和实施，保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。同时，公司董事会、独立董事及董事会审计委员会将切实履行相关职责，加强事后监督检查，持续关注募集资金实际管理与使用情况，加强对募集资金使用和管理的信息披露，确保中小股东的知情权。

（三）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、公司股票上市地上市规则等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东充分行使权利，确保董事会按照法律法规和公司章程的规定行使职权，确保独立董事认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。

（四）不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》等规定以及《上市公司章程指引（2025）》的精神，结合公司实际情况，公司在《公司章程》中对股利分配的条款进行了相应规定。本次发行并上市完成后，公司将根据《公司章程》的规定，保持利润分配政策的连续性与稳定性，高度重视保护股东权益，努力提升股东的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

（五）加强人才队伍建设，积蓄发展活力

多年来，公司培养了一支与国际水平接轨、可持续发展的半导体硅片技术和管理人才队伍。未来，公司将进一步完善绩效考核制度，搭建市场化人才运作模式，建立更为有效的薪酬考核和激励机制，提高整体人力资源运作效率，吸纳引进优秀的管理和技术人才，增强对高素质人才的吸引力，提高公司员工的工作绩效，为公司的持续发展提供保障。

公司将积极履行填补被摊薄即期回报的措施，如违反前述承诺，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将依法履行解释、道歉等相应义务，并积极配合证券监管机构及自律机构依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司股东

造成损失的，将依法承担相应补偿责任。

二、审议和表决情况

公司于 2026 年 2 月 12 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 2、《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司第三届董事审计委员会第九次会议决议》
- 3、《杭州中欣晶圆半导体股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

杭州中欣晶圆半导体股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日